



主要特点

隔离度: 50 dB @ 20 GHz

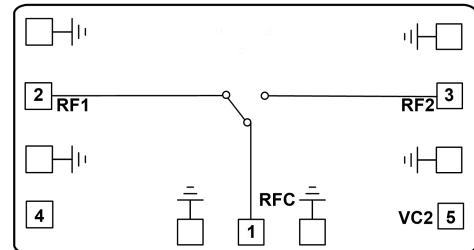
插入损耗: 1 dB @ 20 GHz

反射式设计

供电: -5/+5 V @ -13 mA/17 mA

芯片尺寸: 1.9 × 1.0 × 0.1 mm³

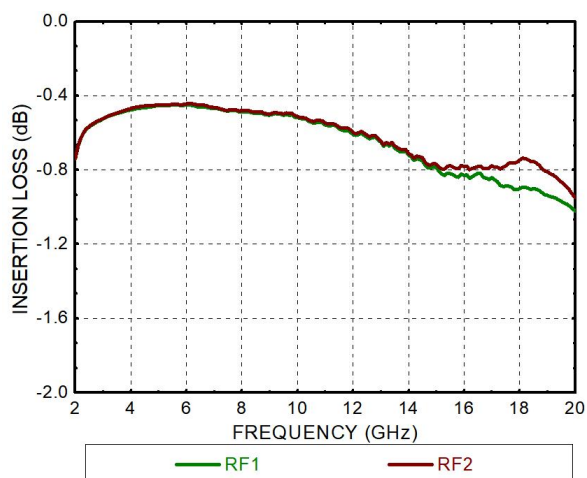
功能框图



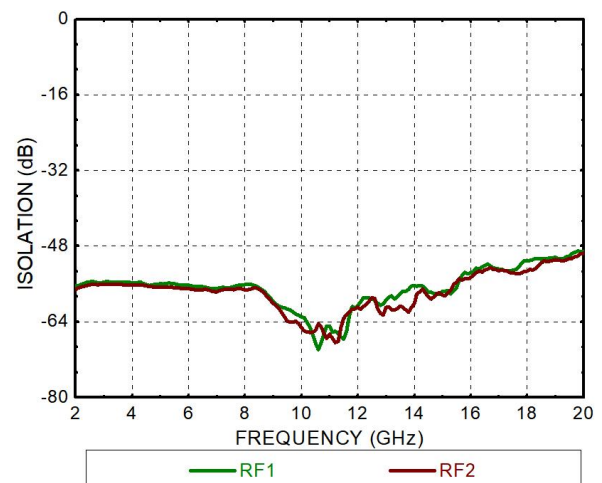
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VC = -5/+5\text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 20			GHz
插入损耗		0.8		dB
隔离度		50		dB
输入回波损耗		18		dB
输出回波损耗		18		dB
输入功率 1dB 压缩点@2-20GHz		25		dBm
开关切换时间		30		ns

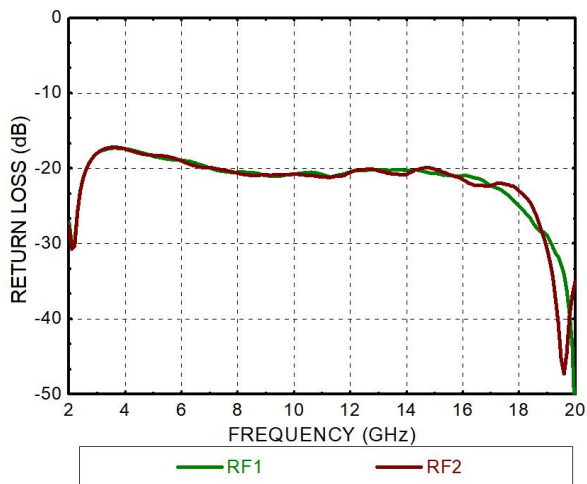
插入损耗



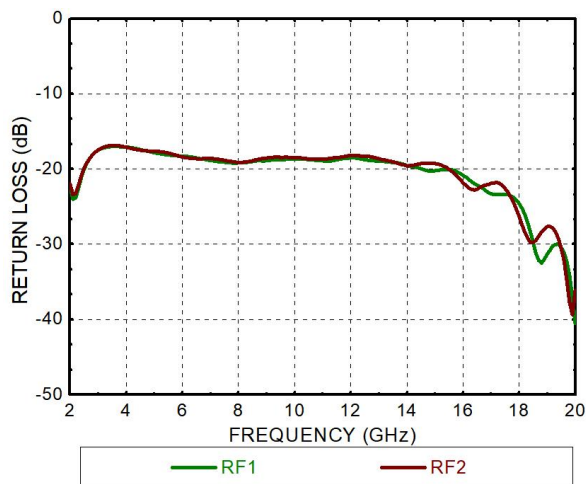
隔离度



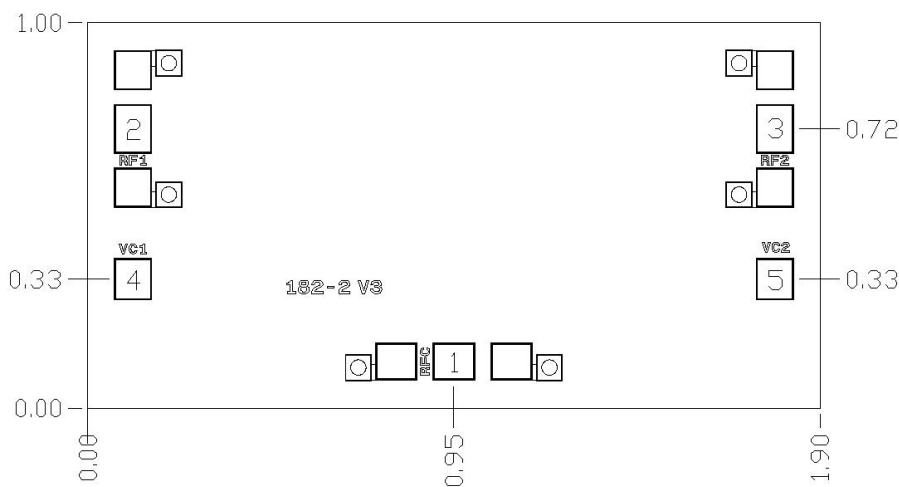
输入回波损耗



输出回波损耗



物理参数



焊盘描述

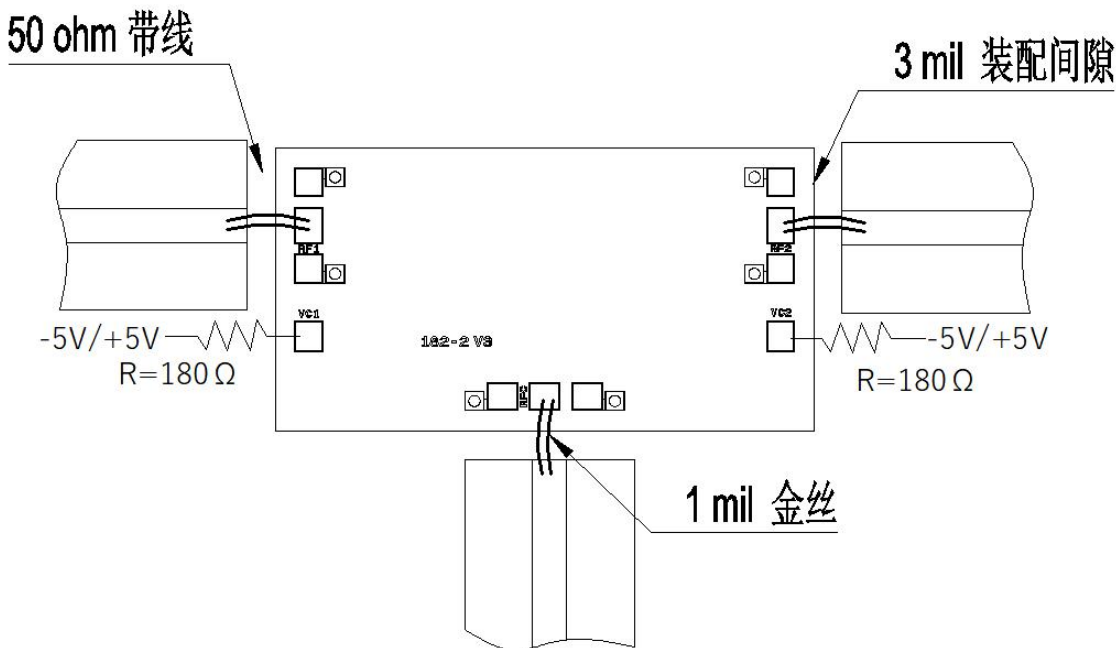
焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是信号输入焊盘, AC 耦合并匹配至 50 Ohm, 内部集成隔直电容
2,3	RF1, RF2	该焊盘是信号输出焊盘, AC 耦合并匹配至 50 Ohm, 内部集成隔直电容
4,5	VC1, VC2	该焊盘是信号控制焊盘, 接-5V / +5V 电压控制支路导通关断
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

VC1	VC2	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V@-13mA	+5V@+17mA	导通	关断
+5V@+17mA	-5V@-13mA	关断	导通

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*90 μm^2
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接
7. 本产品采用空气桥工艺

极限参数

1. 电源电压: -6 V, +6 V
2. 射频输入功率: +33 dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度: -55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$